

江苏捷捷微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163号）同意，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2017年3月通过深圳证券交易所发行A股2,360万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币27.63元，收到股东认缴股款共计人民币65,206.80万元，扣除发行费用4,961.94万元之后，募集资金净额为60,244.86万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48450001号验资报告验证，上述募集资金已于2017年3月9日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司启东市支行开立的1111629929100545140募集资金专户。

截至2018年6月30日止，募集资金专户余额为人民币4,481.73万元，其中本金为人民币4,325.43万元，利息为人民币156.30万元。

（二）前次募集资金结存情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	60,244.86
减：已累计使用募集资金	55,919.43
加：收到银行利息	156.30
截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	4,481.73

截至 2018 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户名	开户银行	账号	存储余额	备注
江苏捷捷微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600000248	1655.50	募集资金专户
捷捷半导体有限公司	招商银行股份有限公司启东支行	513903607410611	1960.45	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100019864	865.78	募集资金专户
	合计		4481.73	

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，公司 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于半导体防护器件生产线建设项目、功率半导体器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目。

截至 2018 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

公司于 2017 年 6 月 5 日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟变更募集资金投资项目中的“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体及实施地点。其中，

实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”），即由捷捷半导体实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。保荐机构西南证券股份有限公司以及公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	18,696.00	17,917.76	778.24	工程处于验收期，主要工程量为设备安装调试及验证，差异额为工程尾款。
半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	15,774.30	13,850.47	1,923.83	差异额主要为工程与设备余款和项目流动资金部分。
工程技术研究中心项目	4,500.00	4,500.00	2,876.64	1,623.36	项目尚未完成建设，尚处于建设期。
补充营运资金项目	22,600.00	21,274.56	21,274.56		
合计	61,570.30	60,244.86	55,919.43	4,325.43	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

(1) 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(2) 前次募集资金投资项目置换的情况

公司于2017年6月5日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计

19,432.22 万元，情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	利用募集资金	置换预先投入金额
1	功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	18,696.00	7,359.74
2	半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	15,774.30	10,616.38
3	工程技术研究中心项目	4,500.00	4,500.00	1,456.10
4	补充营运资金项目	22,600.00	21,274.56	
	合计	61,570.30	60,244.86	19,432.22

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】48450012号《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构西南证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司尚有募集资金 4,481.73 万元未使用，占募集资金总额的 7.44%。公司尚未使用的募集资金将按照既定的用途继续投入功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目和工程技术研究中心项目。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告、2018 年半年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：万元

序号	投资项目	2017 年年末累计			2018 年 6 月末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	半年报披露	差异	
1	功率半导体器件生产线建设项目	11,702.38	11,702.38	0.00	17,917.76	17,917.76	0.00	
2	半导体防护器件生产线建设项目	13,387.70	13,387.70	0.00	13,850.47	13,850.47	0.00	
3	工程技术研究中心项目	1,941.74	1,941.74	0.00	2,876.64	2,876.64	0.00	
4	补充营运资金项目	21,274.56	21,274.56	0.00	21,274.56	21,274.56	0.00	
	合计	48,306.38	48,306.38	0.00	55,919.43	55,919.43	0.00	

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告、2018 年半年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			60,244.86			已累计使用募集资金总额			55,919.43	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
						其中：2017 年			48,306.38	
变更用途的募集资金总额比例			-			2018 年 1-6 月			7,613.05	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功率半导体器件生产线建设项目	功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	18,696.00	17,917.76	18,696.00	18,696.00	17,917.76	-778.24	2018 年 12 月 31 日
2	半导体防护器件生产线建设项目	半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	15,774.30	13,850.47	15,774.30	15,774.30	13,850.47	-1,923.83	2017 年 12 月 31 日
3	工程技术研究中心项目	工程技术研究中心项目	4,500.00	4,500.00	2,876.64	4,500.00	4,500.00	2,876.64	-1,623.36	2018 年 12 月 31 日
4	补充营运资金项目	补充营运资金项目	21,274.56	21,274.56	21,274.56	21,274.56	21,274.56	21,274.56	-	/
合计			60,244.86	60,244.86	55,919.43	60,244.86	60,244.86	55,919.43	-4,325.43	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (注 1)	最近三年一期实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2015	2016	2017	2018 年 1-6 月		
1	功率半导体器件生产线建设项目	不适用	3,029.16	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 (注 2)	
2	半导体防护器件生产线建设项目	46.12%	3,516.24	不适用	不适用	不适用	1,436.24	1,436.24 (注 3)	
3	工程技术研究中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
4	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注 1: 功率半导体器件生产线与半导体防护器件生产线承诺效益系指年均利润总额。

注 2: 截至到 2018 年 6 月 30 日, 功率半导体生产线建设项目累积投资金额 17,917.76 万元, 投资进度为 95.84%, 目前主要工程处在验收期, 主要工程量为设备安装调试及验证, 预计年内完成试生产, 建成投产后第三年达到设计产能。本项目目前尚未产生效益, 预计 2021 年达到预计效益。

注 3: 截至到 2018 年 6 月 30 日, 半导体防护器件芯片生产线项目累积投资金额 13,850.47 万元, 投资进度为 87.80%, 尾款主要是工程与设备余款和项目流动资金部分。本项目于 2017 年底完成试生产, 2018 年已正式投产, 预计 2020 年达到预计效益。由于该项目刚建成投产不久, 受产品周期 (产能释放和预计达产主要受客户认证周期等影响)、IDM (投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与验证复杂, 前期的单位环境净化运行成本和单位折旧占比高等影响)、人员配备等因素影响, 该项目的设计产能尚未完全释放, 产能及效益均处在爬坡阶段。2018 年上半年, 该项目实现营业收入为 9,357.98 万元, 利润总额为 1,436.24 万元, 净利 1,077.18 万元。